



Toshiba разрабатывает модули IEGT на 4,5 кВ в плоском корпусе повышенной прочности на разрыв

Новая конструкция корпуса обеспечивает повышение прочности на разрыв в 1,7 раза по сравнению с традиционными плоскими корпусами.

Дюссельдорф, Германия, 13 июня 2018 г. – Компания Toshiba Electronics Europe представила подробную информацию о новом корпусе для устройств IEGT класса 4,5 кВ в плоском корпусе (PPI) на конференции PCIM 2018 в Нюрнберге. Новый корпус разработан в целях дальнейшего повышения прочности устройств на разрыв, тем самым снижая вероятность повреждения окружающих компонентов и систем в случае отказа устройства.

Создание корпуса явилось результатом исследований, проведенных для оценки оптимального объемного соотношения материалов в таких корпусах. Путем экспериментов было определено оптимальное соотношение, при котором не происходит ни разрушение керамических элементов, ни утечка материалов.

По результатам тщательных измерений было показано, что корпус может выдерживать 50 часов в режиме отказа вследствие короткого замыкания (SFCM). Эксперимент проводился с одним короткозамкнутым кристаллом IEGT из 42, расположенным на краю модуля (наиболее неблагоприятная ситуация).

Кроме того, испытания прочности на разрыв, проведенные в тестовых условиях при 3200 В, показали в 1,7 раза большую прочность по сравнению со стандартными PPI-устройствами.

###

О компании Toshiba Electronics Europe

Компания [Toshiba Electronics Europe GmbH](http://www.toshiba-semicon-storage.com) (ТЕЕ) – европейское подразделение по производству электронных компонентов корпорации [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](http://www.toshiba-semicon-storage.com). Компания ТЕЕ предлагает европейским потребителям и корпоративным заказчикам широкий ассортимент инновационных жестких дисков (HDD), а также полупроводниковые решения для применения в автомобильных и промышленных системах, устройствах Интернета вещей, системах управления перемещением, телекоммуникационных и сетевых устройствах, бытовых приборах и крупной бытовой технике. Широкий спектр продукции компании включает ИС с встроенными модулями беспроводного обмена данными, силовые полупроводниковые приборы, микроконтроллеры, оптические полупроводниковые устройства, специальные и специализированные интегральные микросхемы и дискретные компоненты от диодов до логических ИС.

Головной офис ТЕЕ находится в г. Дюссельдорф, Германия. Компания имеет филиалы в Франции, Италии, Испании, Швеции и Великобритании. Компания осуществляет разработку, производство, маркетинг и продажи продукции. Президент компании – г-н Акира Моринага (Akira Morinaga).

Подробнее о компании ТЕЕ: www.toshiba-semicon-storage.com.

Контакты по вопросам публикации:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Телефон: +49 (0) 211 5296 0 Факс: +49 (0) 211 5296 79197

Веб-сайт: www.toshiba-semicon-storage.com/eu/company/news.html

Электронная почта: discrete-ic@toshiba-components.com

Контакты для редакционных запросов:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Телефон: +44 (0)193 282 2832

Электронная почта: MShrimpton@teu.toshiba.de

Опубликовано:

360 Service Agency

Веб-сайт: www.360serviceagency.com

Электронная почта: tee_ru@360serviceagency.com